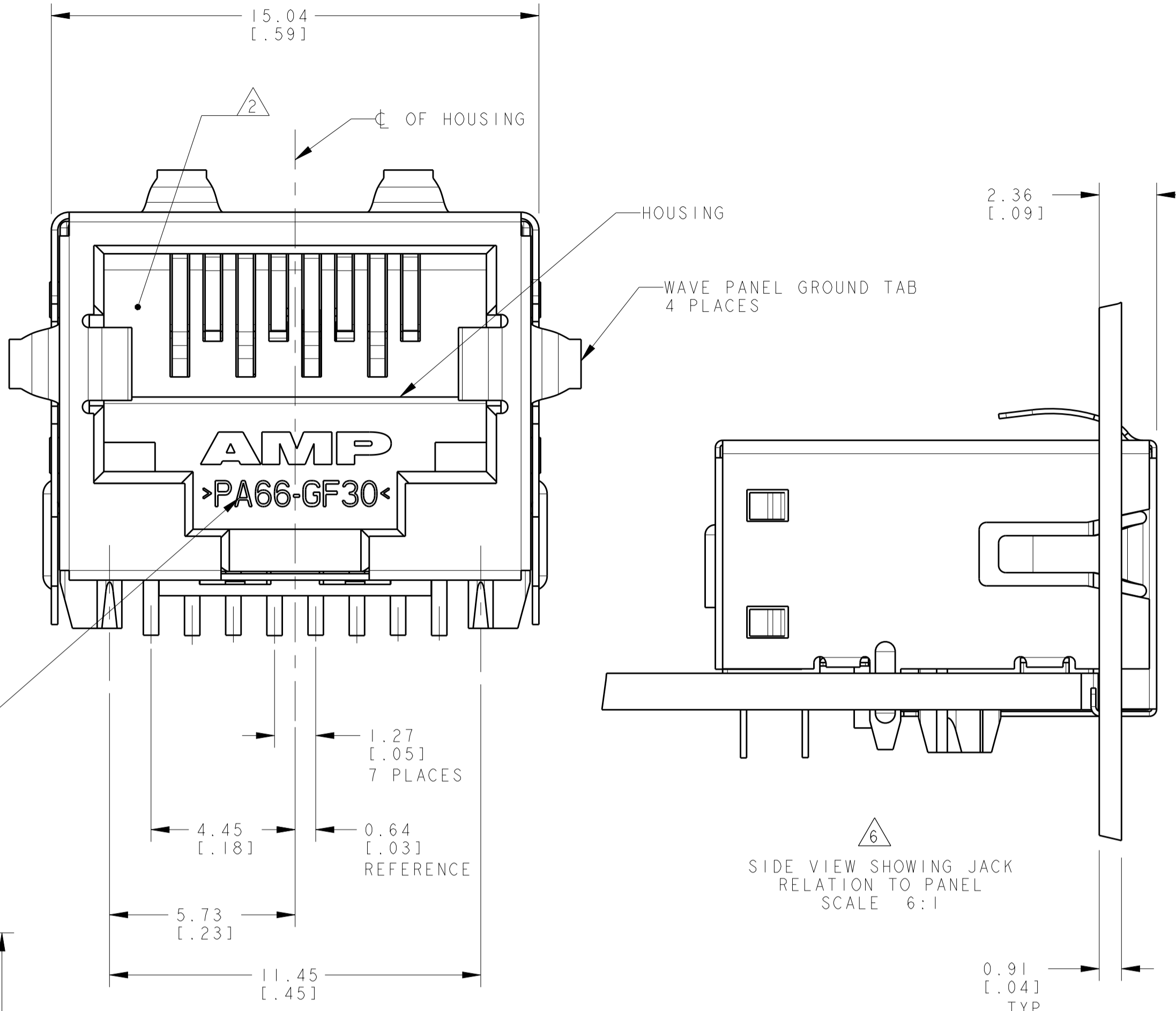
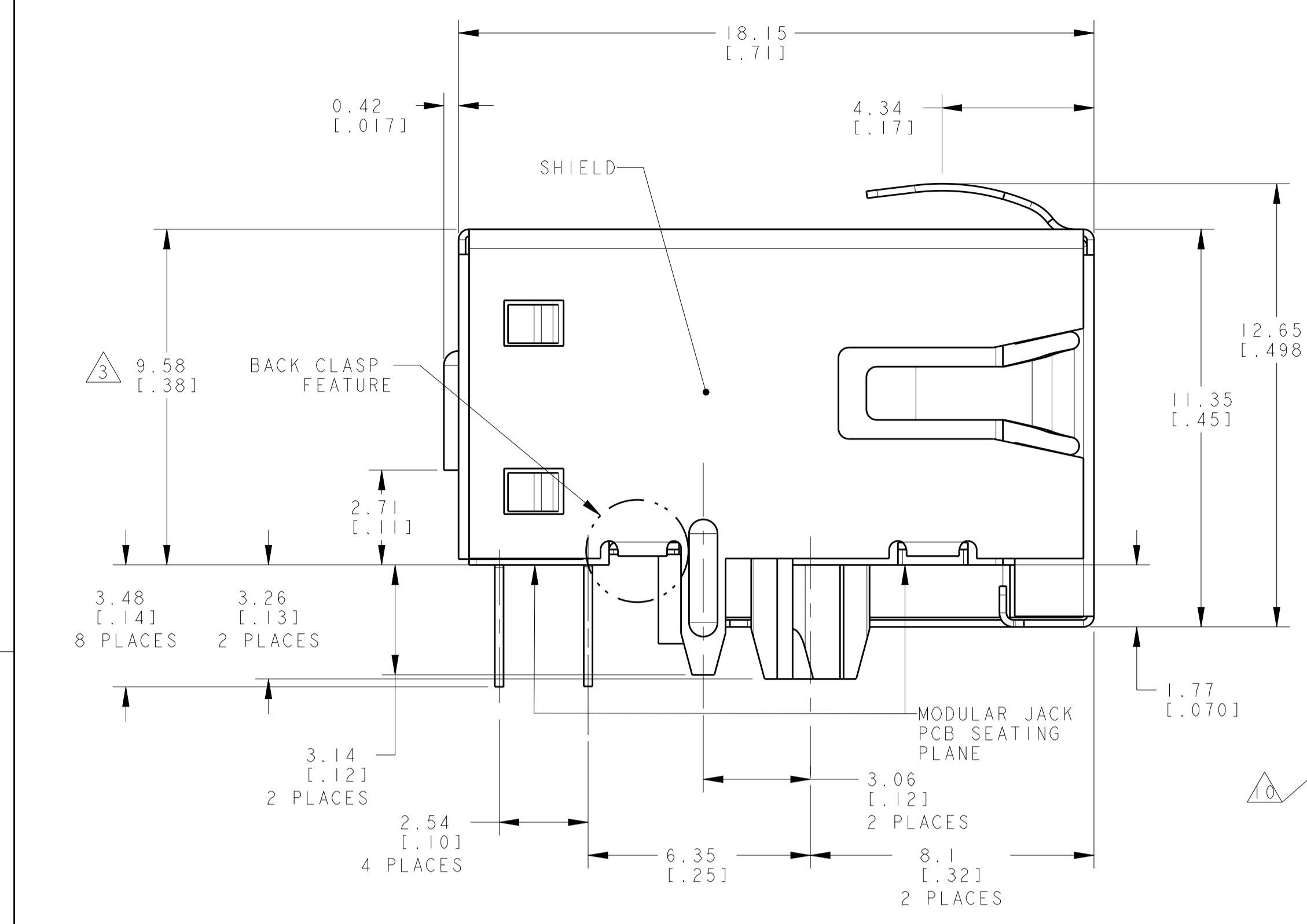
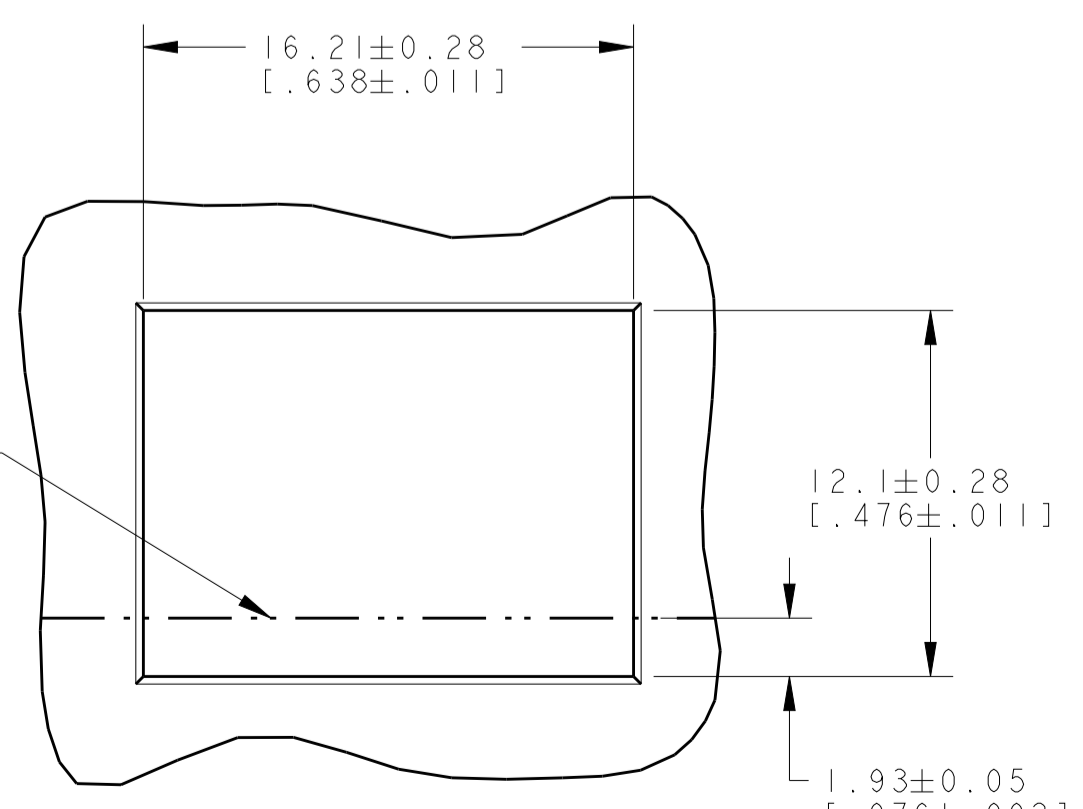
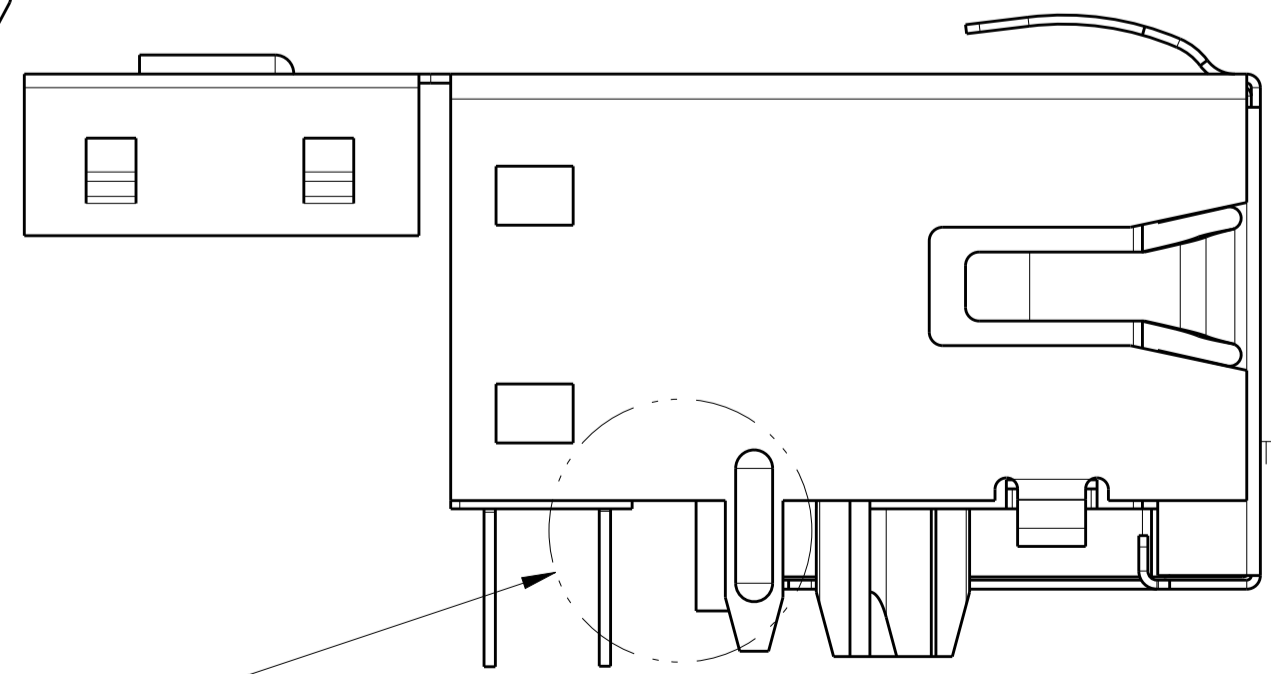
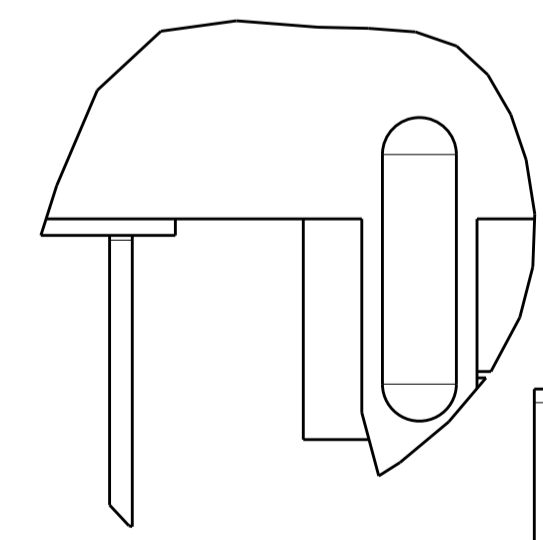
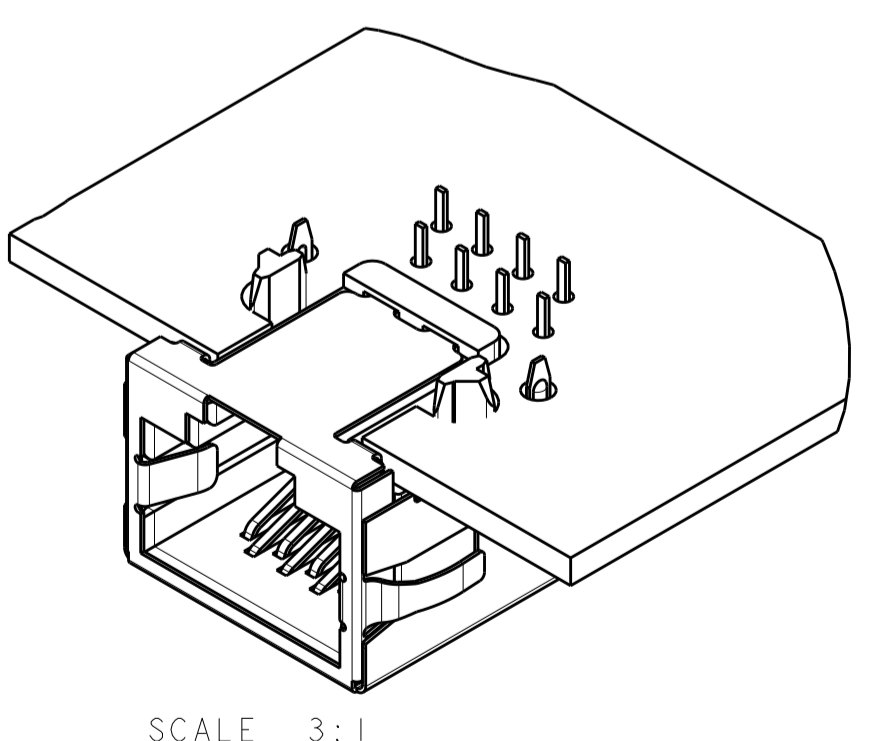
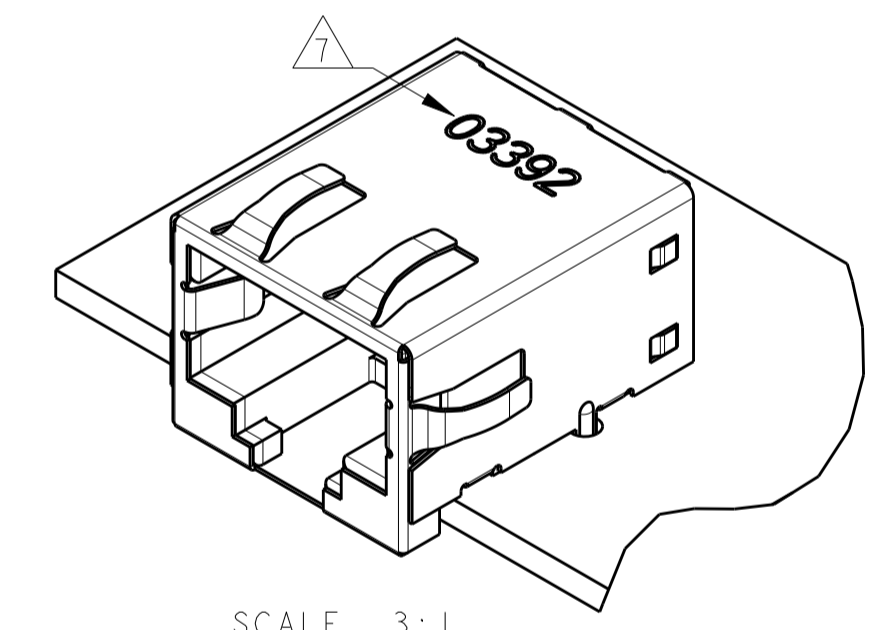
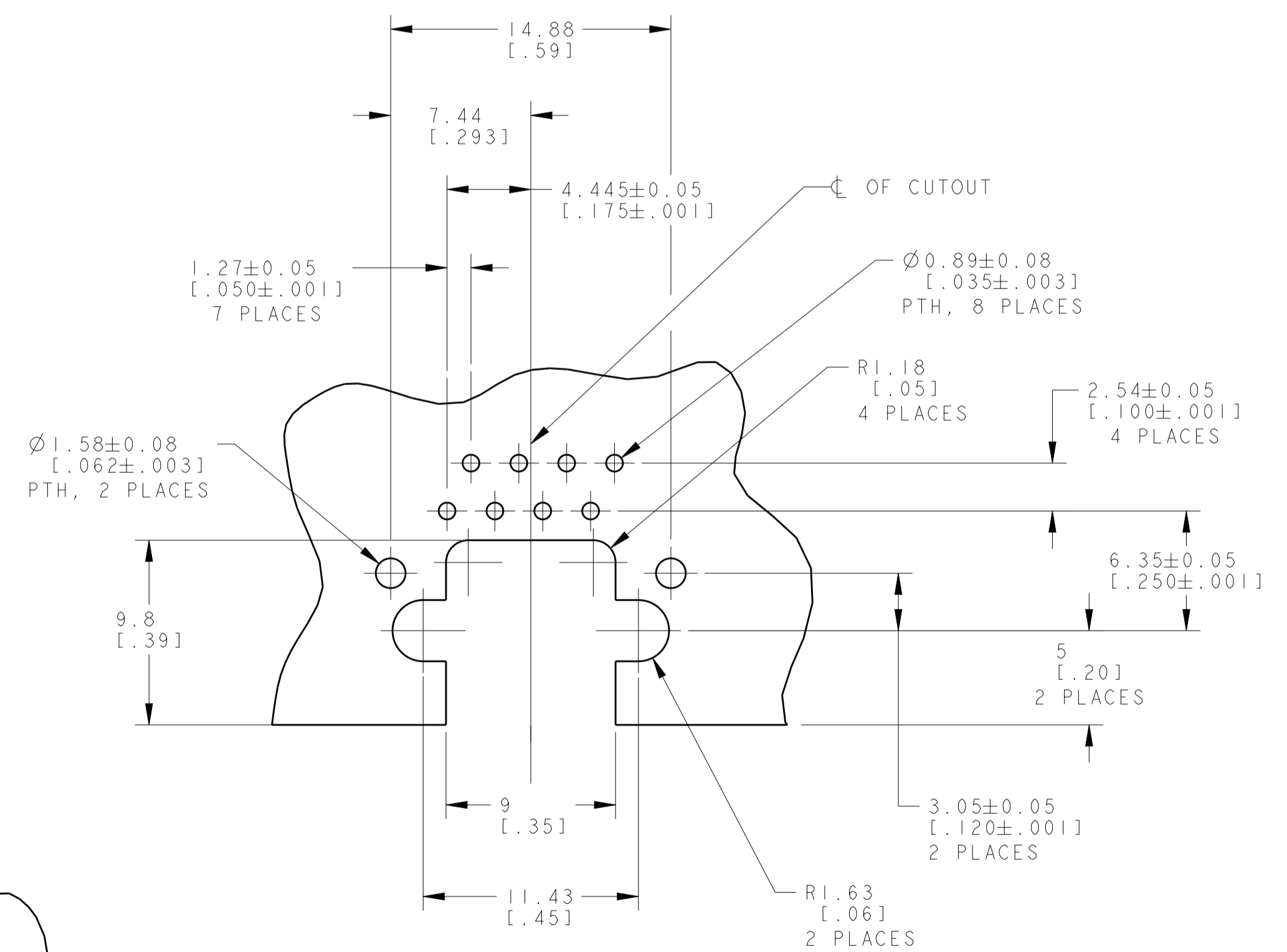
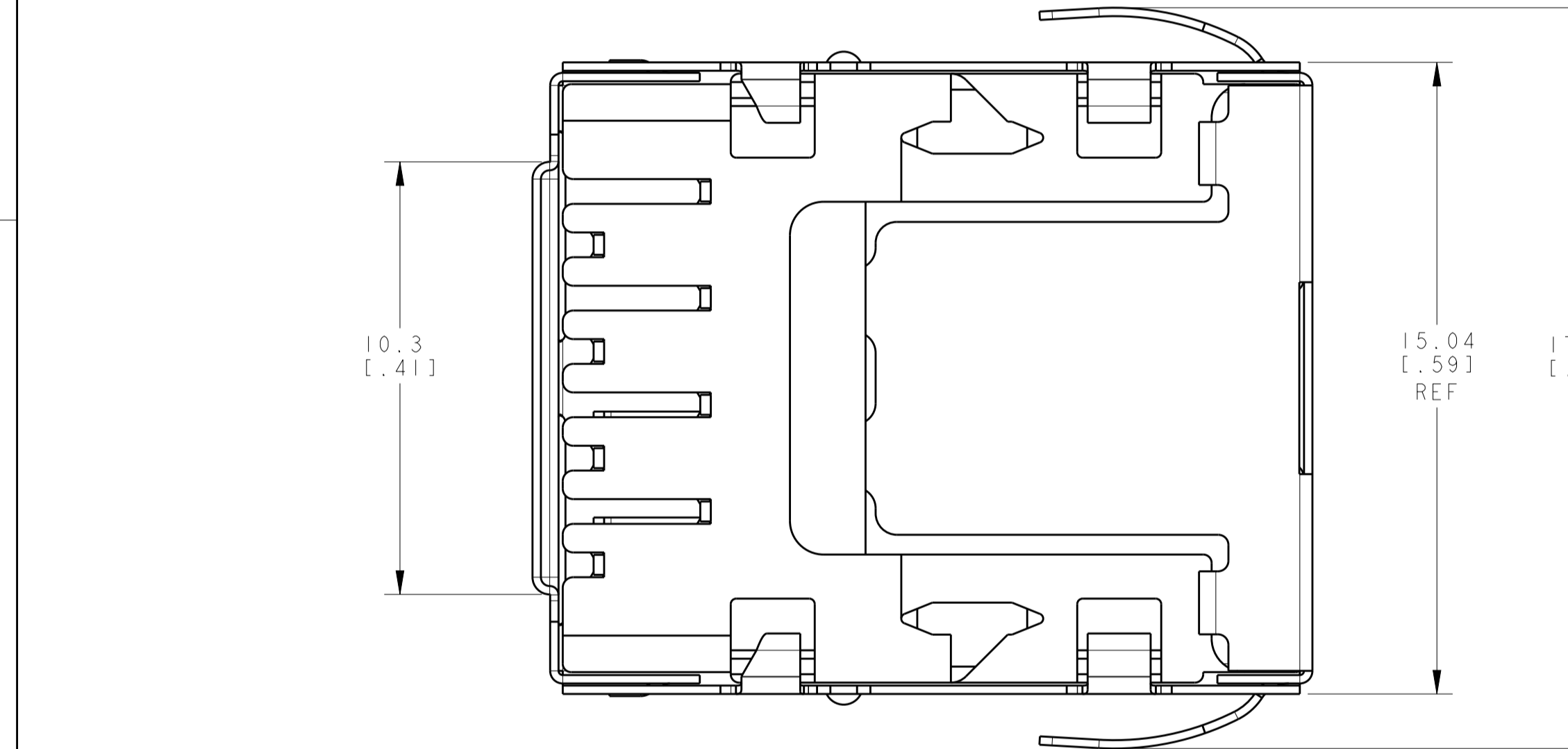


REVISIONS				
P.	LTN.	DESCRIPTION	DATE	OWN. APVD.
C		REVISE PER ECO-14-015233	27APR2015	LL SH
D		REVISE PER ECO-17-005794	23FEB2016	LL SH



- △ MATERIAL: HOUSING - HIGH TEMPERATURE NYLON, BLACK, UL 94V-0
 TERMINALS - 0.25[.01] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH
 3.81µm[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN
 SOLDER AREA, 1.27µm[.000050] MINIMUM GOLD IN
 LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH
 1.27µm[.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
 SHIELD - 0.1[.0039] MIN THICK COPPER ZINC ALLOY,
 PREPLATED WITH 2.0-4.0 µm (.000079-.000157) THICK
 BRIGHT TIN OVER 1.27 µm (.000050) MIN. THICK NICKEL.
- △ JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS
 PART 68, SUBPART F.
- △ THIS DIMENSION REPRESENTS THE TOTAL HEIGHT OF THE
 CONNECTOR FROM THE TOP OF THE PC BOARD.
- 4. PACKAGED 66 ASSEMBLIES PER PVC TRAY, XX PER BOX.
- 5. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE BETWEEN SHIELD
 AND CONTACT IS 1500 VAC (RMS) PER IEEE 802.3.
- △ SEE TYCO PN 1116062-1 FOR IEEE 1386 MEZZANINE PCI
 CARD APPLICATIONS. PN 1658869-1 IS NOT COMPATIBLE
 WITH IEEE 1386 BEZEL.
- △ MANUFACTURING DATE CODE:
 ORIENTED AND LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN.
 LASER PRINTING. TEXT HEIGHT APPROX. 2MM.
 FIRST 2 DIGITS = LAST 2 DIGITS OF YEAR
 NEXT 2 DIGITS = MANUFACTURING WORK WEEK
 LAST DIGIT = DAY OF WEEK WITH SUNDAY = 1
- △ MATERIAL: HOUSING - HIGH TEMPERATURE NYLON, BLACK, UL 94V-0
 TERMINALS - 0.25[.01] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH
 3.81µm[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN
 SOLDER AREA, 1.27µm[.000050] MINIMUM GOLD IN
 LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH
 1.27µm[.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
 SHIELD - 0.1[.0039] MIN THICK COPPER ZINC ALLOY,
 PLATED WITH 1.27 µm (.000050)MIN. THICK NICKEL AND
 2.03 µm (.000080) MIN. THICK HOT TIN DIP ON PCB GROUND TABS.
- △ MATERIAL: HOUSING - LCP, NATURE, UL94V-0.
 OTHER MATERIAL SAME AS NOTE 8.
- △ >LCP-GF30< MARK ONLY FOR 1888542-4.
- △ THE PN 1888542-4 SHALL MEET LOW BR/CL/F AS DEFINED IN TEC-138-702.



SCALE 6:1
 P/N: 1888542-3, -4
 FEATURE SAME AS 1888542-2
 EXCEPT AS SHOWN WITHOUT
 BACK CLASP FEATURE

SUGGESTED PANEL CUTOUT
 SCALE 4:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN: BRIAN KUHNLYZ & MAYER	DATE: 07JUNE2006	REV: 1
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK: J. WESTMAN	DATE: 07JUNE2006	REV: 1
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD: S. FLICKINGER	DATE: 07JUNE2006	REV: 1
0 PLC	±	PRODUCT SPEC		
1 PLC	±	APPLICATION SPEC		
2 PLC	±	108-1163		
3 PLC	±	114-2048		
4 PLC	±	114-2048		
MATERIAL: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE	WEIGHT: 3.49 grams	SIZE: A1
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 3:1		SHEET 1 OF 1

T&R	△ 9 △ 10 △ 11	1888542-4
TRAY	△ 8	1888542-3
TRAY	△ 7	1888542-2
PACKAGE	MATERIAL / FINISH	PART NUMBER



MODULAR JACK ASSEMBLY,
 8 POSITION, SHIELDED, 10mm,
 WAVE PANEL GROUND TABS



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.